

NISSOCURE

TIC-188



日本曹達株式会社

化学品事業部機能化学品部機能材料課

包接技術とは？

分子（ホスト）が形成する結晶空間に別の分子（ゲスト）を分子単位で閉じ込めるものです。

包接触媒

包接技術を用い、イミダゾール類を結晶空間に閉じ込めました。
これら、包接された触媒は特徴あるエポキシ硬化挙動を示します。

効果

- 常温での触媒活性を抑制
- ポットライフの向上
- 流動性の向上

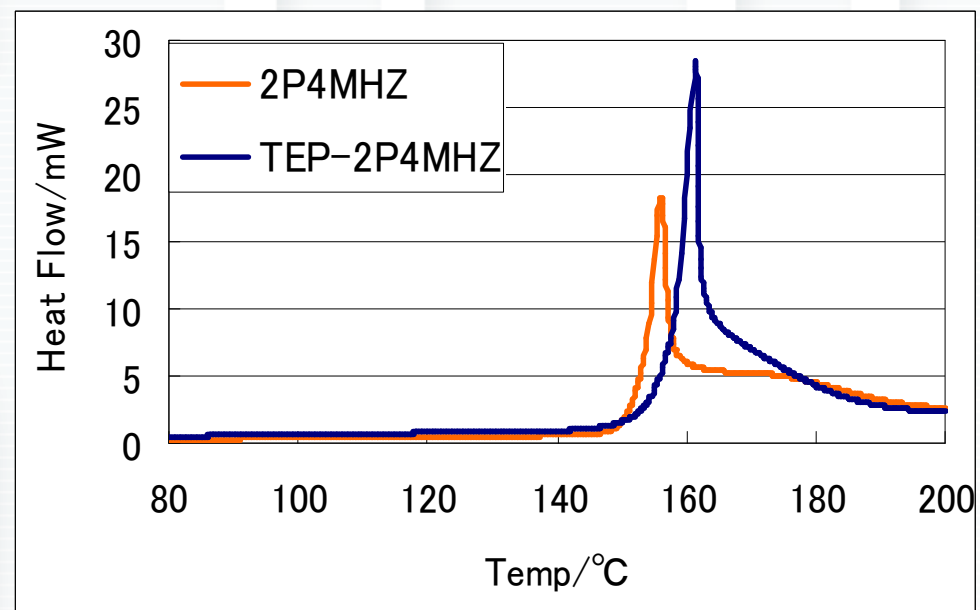
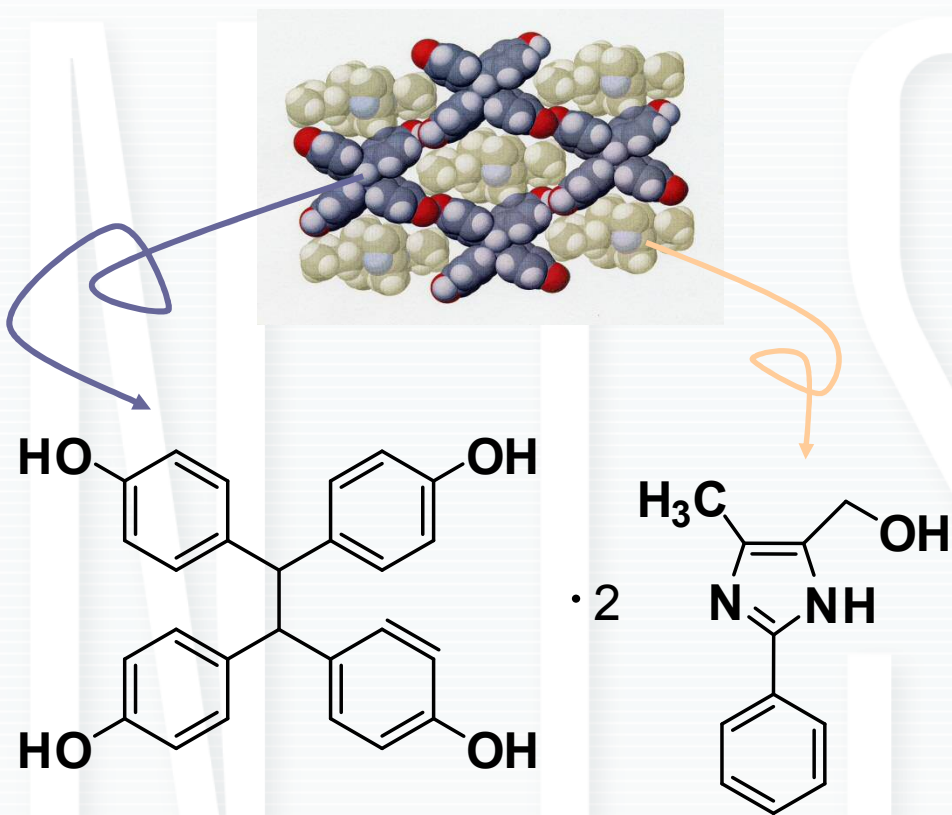
用途

- 半導体封止材
- 絶縁材
- 接着剤
- その他エポキシ樹脂硬化用途

TIC-188

【DSC測定組成】

液状エポキシ樹脂 : 100 硬化触媒 (2P4MHZとして) : 4



NISSOCURE TIC-188の効果

【組成】

オークレゾールノボラックエポキシ樹脂:100

ノボラックフェノール型硬化剤:50

離型剤:2

シランカップリング剤:5

球状シリカ:900

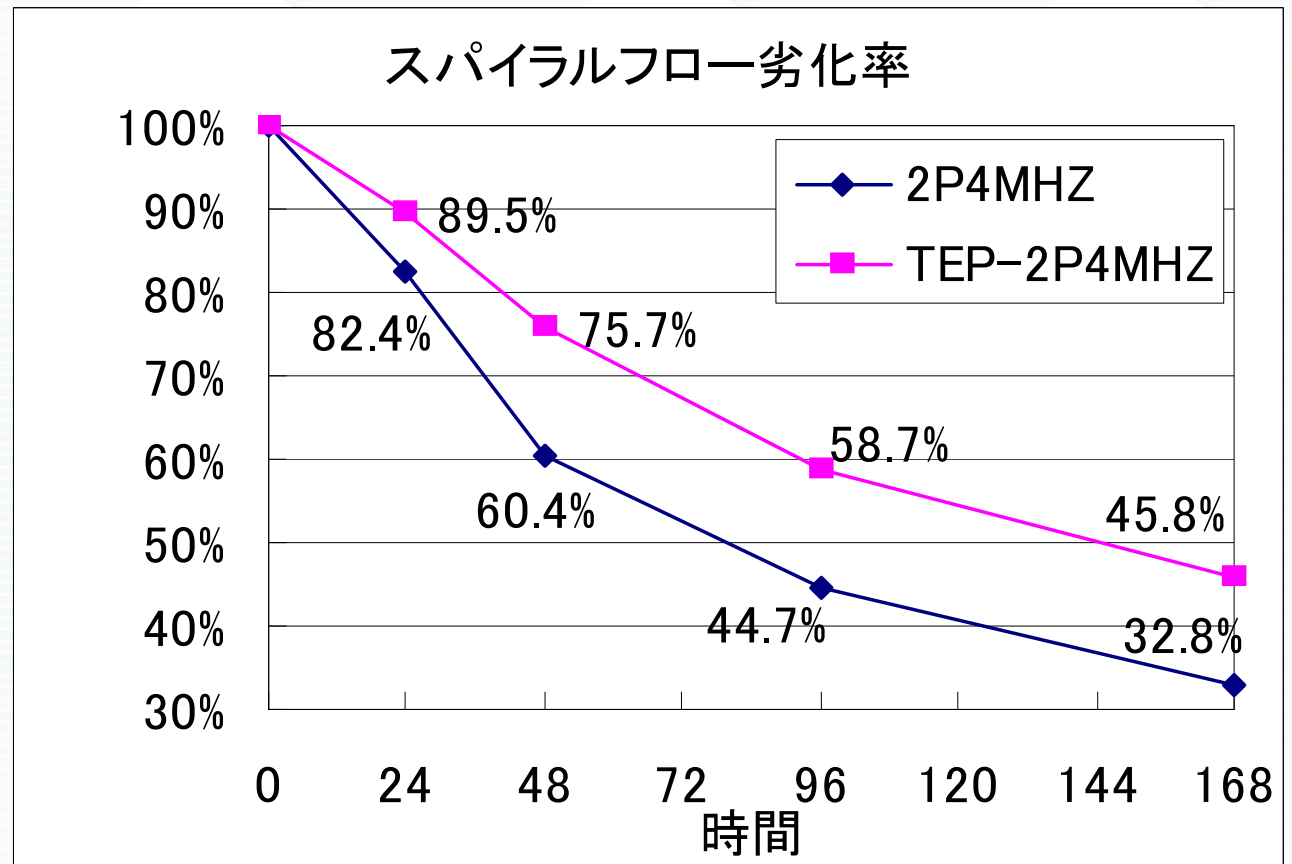
硬化触媒(2P4MHZとして):2

【保存試験温度】 25°C

【成形条件】

175°C × 70kgf/cm² × 3分間

トランスファーラム速度 5cm/sec



お問い合わせ先

ご興味がありましたら下記までお問合せください

日本曹達株式会社 化学品事業部
機能化学品部機能材料課

東京都千代田区大手町2-2-1

TEL: 03-3245-6203

FAX: 03-3245-6277